

한화

저밀도 폴리에틸렌

5325

블로운 필름용 제품

용융지수 4.0
밀도 0.923

한화 LDPE 5325의 주용도는 일반 포장용 필름이며 가공성, 기계적 물성이 우수한 제품입니다.
한화 LDPE 5325는 미국 FDA의 21 CFR 177.1520 (c) 2.1. 규정에 적합한 제품입니다.

■ 제품 특징

가공성
기계적물성

■ 적정 가공 조건

가공 온도 : 140 ~ 170℃
팽창비 : 2 ~ 3
두께 : 25 ~ 100 μm

■ 첨가제

■ 제품 물성

수지 물성	단위	시험 방법	대표값
용융지수	g/10 분	ASTM D1238	4.0
밀도	g/cc	ASTM D1505	0.923
Vicat 연화점	℃	ASTM D1525	87
용융점	℃	ASTM D2117	111
인장강도(파단점)	kg/cm ²	ASTM D638	115
연신율(파단점)	%	ASTM D638	650
필름 물성	단위	시험방법	대표값
두께	mm	HCC 방법	0.03
인장강도(파단점), 세로/가로	kg/cm ²	ASTM D882	220/170
인장인열강도, 세로/가로	kg/cm	ASTM D1004	90/80
연신율(파단점), 세로/가로	%	ASTM D882	300/550
낙하충격강도	g	ASTM D1709	60
흐림도	%	ASTM D1009	5.0
45° 광택도	%	ASTM D2457	80

* 필름 압출기 사양 및 가공 조건:

40mmφ LLD/LD 겸용 스크류, 75mmφ 다이, 1.5mm 다이갭, 듀얼립 에어링
가공온도(호퍼부~다이부) 170 ~ 190℃, 팽창비 2

1. 상기의 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
2. 상기 특성치는 기기특성이나 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다.



한화솔루션